

2024 11/14

化合物半导体与硅光子技术研讨会

Compound Semiconductor and Silicon Photonics Technology Seminar

在电动车与新能源市场需求下，化合物半导体材料如碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 具高频率、耐高压、优异的散热性能和高效能转换，成为车用半导体及电源管理IC的关键技术。在晶圆制造、检测分析如材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 及车用半导体测试，有效掌握从研发到量产的制程。

面对高效能运算和AI趋势，硅光子和先进封装技术，包括3DIC及硅光子技术，显著提升带宽互连能力。硅光子在高速通信和数据传输中展现出替代传统电子组件的潜力，带来高效能、低耗能的数据处理，提高系统整合密度和效率。特别是在AI、电动车 (EV) 及高速通信，硅光子和化合物半导体技术结合自动化为提升性能和效率提供重要支持。

筑波科技与美商Teradyne合作，推广ETS解决功率器件和功率模块测试，并利用太赫兹检测分析技术，应对非破坏性Wafer材料测试及3DIC高阶封装的测试挑战。诚挚邀请业界先进共同莅临参与。

PM 12:30 -13:00	报到登记 Registration	
13:00 - 13:15	欢迎致词 Welcome	Steve Hsu, President, ACE 许深福 董事长 筑波科技
13:15 - 13:40	利用ETS测试系统应对高功率模拟与混合讯号测试挑战 Addressing High-Power Analog and Mixed-Signal Testing Challenges Using the ETS Testing System	Greg Chiu, Engineering Project Manager, ACE 邱世耀 工程部项目经理 筑波科技
13:40 - 14:05	Recent Progress of SiPh for AI Data Center	Prof. Hao-Chung Kuo, NYCU, Department of Photonics/ SEMI Taiwan 郭浩中 教授 阳明交大 光电工程研究所
14:05 - 14:30	Compound Semiconductor Photomixer for Terahertz Wave Application	Prof. Kazutoshi KATO, Graduate School of Information Science and Electrical Engineering, Kyushu University 加藤 和利 教授 九州岛大学 系统信息科学研究生院 信息电子学系
14:30 - 15:10	中场休息/ 方案展示 Tea Break/ Showcase A: 高功率模拟与混合讯号测试测试方案 B: 光通讯模块化测试整合方案 (Silicon Photonics) C: 化合物半导体Wafer及材料非破坏性测试方案 D: UR与MiR的协作解决方案	
15:10 - 15:35	如何创新氮化镓基板材料来引领多元应用市场 How to Innovate GaN Substrate Materials to Lead the Diverse Applications Market	Hertz Hsu, Sr. Director, New Product Technology Division, Wafer Works 徐文浩 新产品技术处资深处长 合晶科技
15:35 - 16:00	UR (协作型机器手臂) 与 MiR (自主载具车) 的协作解决方案：智能自动化的应用 Collaborative Solutions of UR (Collaborative Robot Arms) and MiR (Autonomous Mobile Robots): Intelligent Automation Applications	SF Hsu, General Manager, ACE 徐舜范 总经理 筑波科技
16:00 - 16:25	以PXIE接口提升硅光子光电整合测试效率：相干光技术验证与多通道解决方案 Enhancing Silicon Photonics Optoelectronic Integration Test Efficiency via PXIE Interface: Verification of Coherent Optical Technology and Multi-Channel Solutions	Gary Wu, System Integration Manager, ACE 吴煜坤 系统整合项目经理 筑波科技
16:25 - 16:50	化合物半导体材料Wafer与3DIC测试的挑战与应用 Challenges and Applications of Compound Semiconductor Materials Wafer and 3DIC Testing	Antony Hsu, Project Manager, ACE 许永周 项目经理 筑波科技
16:50 - 17:00	交流/ Q&A	

 2024/11/14 (四) 12:30 – 17:00

 诺贝尔讲堂 - 新竹县竹北市生医二路66号 筑波医电大楼1F (新竹生医园区)

 +886-3-5500909 ext. 3407 林小姐 / 3502 郑小姐 service@acesolution.com.tw